



Deutsche IMAPS Konferenz

8./9. Oktober 2007, München

Call for Papers

Wie bereits Tradition findet die Deutsche IMAPS-Konferenz 2007 an der Technischen Universität in München statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu einem der folgenden Themen der *Mikroelektronik*, des *Packaging* bzw. der *Aufbau- und Verbindungstechnik* einen Vortrag von ca. 20 Minuten Dauer halten:

Anwendungsfelder

Telekommunikation
Medizintechnik
Automobilelektronik
Luft- und Raumfahrt
Industrieelektronik
Logistik
Sensorik

Systemaspekte/Problemlösungen

Zuverlässigkeit & Lebensdauer
Packaging
Halbleiter, MEMS, System in Package, Chip
Scale Packages, MCM, System on Chip
Fluidiksysteme
Optoelektronik
Mechatronische Systeme
Hochtemperaturelektronik
Leistungselektronik
Hochfrequenzelektronik
Prüfsysteme

Entwurf

Designsoftware
fertigungsgerechtes, testgerechtes Design
Simulation
thermische, thermomechanische,
Hochfrequenz-, Mikrowellensimulation

Prozesse und Materialien

Wafer Level Prozesse
Keramische und organische Verdrahtungsträger
Materialien, 3D-Formung, HDI-Prozesse,
Inkjetdruck, Siebdruck, Fotolithografie,
Laserstrukturierung ...
Materialien
(Kleber, Lote und Vergussmassen,
Nanomaterialien, funktionelle Schichten)
Montage- und Verbindungstechnologien
FlipChip, Drahtbonden, SMT,
andere Verfahren
Prozessüberwachung

Bitte senden Sie Ihren Abstract (ca. 200 Wörter) bis zum **27. Juni 2007** an:

Dr.-Ing. Gisela Dittmar, Ingenieurbüro Elektroniktechnologie Dittmar, Albrecht-Erhard-Str. 17, D-73433 Aalen,
Tel. 07361/931129, Fax 07361/943004, gisela.dittmar@imaps.de

Es wird wieder ein BEST PAPER AWARD vergeben !

☞ **Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit der Online-Anmeldung unter: <http://www.imaps.de/>** ☞

Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Oulu, Finnland	17./20.6.2007	EMPC 2007 – 16 th European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition	IMAPS Nordic / Europa
Rzeszów-Krasiczyn	23./26.9.2007	31 th International IMAPS Poland Conference and Exhibition	IMAPS Poland
München	8./9.10.2007	IMAPS Konferenz 2007	iMAPS D
München	10./11.10.2007	Advanced Packaging Conference	SEMI, IMAPS Europe
Dresden	15./17.10.2007	Mikrosystemtechnik-Kongress 2007	BMBF, VDE

EMPC 2007

Nur noch wenige Wochen, dann findet in Oulu die *EMPC 2007* statt. Sie steht unter dem Motto *Light from the North* und aufgrund der geographischen Breite von Oulu und des Zeitpunkts (17. - 20. Juni) wird es wohl eine „eintägige Veranstaltung“ werden, da die Sonne während der Konferenz kaum untergehen wird. Das Programm und den Konferenzort haben wir bereits in *PLUS 4/2007* vorgestellt, hier soll jedoch noch einmal an diese wichtige europäische Veranstaltung der IMAPS erinnert werden.

www.empc2007.org

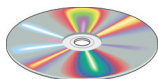
Konferenz der polnischen IMAPS

Die jährliche Konferenz der polnischen IMAPS findet in diesem Jahr im äußersten südöstlichen Zipfel unseres Nachbarlandes, nur etwa 20 km von der ukrainischen Grenze entfernt, statt. Die *31st International IMAPS Poland Conference & Exhibition* wird von der *TU Rzeszów* organisiert und im Zeitraum vom 23. bis 26. September in Krasiczyn abgehalten. Der Tagungsort bietet eine sehr reizvolle Umgebung. Die Räume des Tagungshotels befinden sich in verschiedenen Gebäuden eines Schlosses, welches von einem großen Park umgeben ist. Wie in den vergangenen Jahren auch, wird es sicher eine sehr interessante Veranstaltung mit umfangreicher internationaler Beteiligung.

imaps.prz.edu.pl

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der *Deutschen IMAPS-Seminare 2006* und *2007* zu den Themen *Muss jeder Sensor smart sein?* (Februar 2006 in Göppingen) und *Flip Chip – die Alternative zum Drahtbonden?* (Februar 2007 in Ilmenau) können noch auf CD zum Preis von



€ 55,-

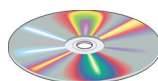
und als Papiaerausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, sind als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

Applikationszentrum Ilmenau

Gustav-Kirchhoff-Str. 5

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381

Fax: 03677/69-3379

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Albrecht-Erhard-Str. 17

D-73433 Aalen

Fon: 07361/931129

Fax: 07361/943004

e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

Schatzmeister

c/o Hesse & Knipps GmbH

Vattmannstraße 6

D-33100 Paderborn

Fon: 05251/1560-14

Fax: 05251/1560-97

e-mail: hans-ulrich.knipps@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer

Schriftführer

c/o FH Schmalkalden

FB Elektrotechnik

D-98574 Schmalkalden

Fon: 03683/688-5116

Fax: 03683/688-5499

e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner

Öffentlichkeitsarbeit

c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit
und Mikrointegration

Chip Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25

D-13355 Berlin

Fon: 030/46403-164

Fax: 030/46403-161

e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek

Öffentlichkeitsarbeit

c/o VIA electronic GmbH

Robert-Friese Straße 3

D-07629 Hermsdorf

Fon: 036601/81-529

Fax: 036601/81-530

e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina

Öffentlichkeitsarbeit

c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Steinplatz 1

D-10623 Berlin

Fon: 030/310078-242

Fax: 030/310078-256

e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe

Öffentlichkeitsarbeit

c/o TU Ilmenau

Fakultät EI

FG Mikroperipherik

Pf 100565

D-98684 Ilmenau

Fon: 03677/69-3429

Fax: 03677/69-3350

e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar

Öffentlichkeitsarbeit

c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH

Klein Grötzing

D-84494 Neumarkt-St. Veit

Fon: 08722/9620-0

Fax: 08722/9620-30

e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter

Öffentlichkeitsarbeit

c/o FHTE Standort Göppingen

Robert-Bosch-Str. 1

D-73037 Göppingen

Fon: 07161/679-157

Fax: 07161/679-233

e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann

Öffentlichkeitsarbeit

EADS Deutschland GmbH

Microwave Factory / Defence Electronics

Woerthstr. 85

D-89077 Ulm

Fon: 0731/392-3879

Fax: 0731/392-3362

e-mail: martin.oppermann@imaps.de